

ICS 37.100.10

N 47

备案号: 49779—2015

# JB

## 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8268—2015

代替 JB/T 8268—1999

### 静电复印光导体表面缺陷测量方法

Test method of surface defect for photoconductor of  
electrostatic copying process

2015-04-30 发布

2015-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布



## 目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 测量条件.....	1
3.1 环境条件.....	1
3.2 测量用样机.....	1
4 测量方法.....	1
4.1 目视检查.....	1
4.2 对比测量.....	1
4.3 背景印迹测量.....	2
5 测量报告.....	2

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 8268—1999《静电复印感光体表面缺陷测量方法》，与JB/T 8268—1999相比主要技术变化如下：

- 修改了标准名称，感光体改为光导体；
- 将适用范围中的感光体改为光导体，删除了硒鼓、硫化镉鼓等已不再使用的感光体，删除了反光镜可参照使用（见第1章，1999年版的第1章）；
- 修改了规范性引用文件（见第2章，1999年版的第2章）；
- 修改了测量环境条件（见3.1，1999年版的3.1）；
- 将有效测量范围放入了测量方法中，删除了测量范围示意图（见4.1.2，1999年版的3.2和图1）；
- 增加了测试用样机的要求（见3.2）；
- 修改了测量方法的编排格式（见第4章，1999年版的第4章）；
- 修改了目视检查的方法（见4.1，1999年版的4.1），删除了目视检查鼓表面示意图（见1999年版的图2）；
- 把缺陷版检查改为对比测量，并修改了检查方法（见4.2，1999年版的4.2）；
- 修改了背景印迹的测量方法（见4.3，1999年版的4.3）；

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国复印机械标准化技术委员会（SAC/TC147）归口。

本标准起草单位：天津复印技术研究所、珠海天威飞马打印耗材有限公司、夏普办公设备（常熟）有限公司、理光图像技术（上海）有限公司深圳分公司、湖北鼎龙化学股份有限公司、柯尼卡美能达（中国）投资有限公司、上海富士施乐有限公司、兄弟（中国）商业有限公司、东芝泰格信息系统（深圳）有限公司、佳能（中国）有限公司。

本标准主要起草人：刘慧玲、张希平、王强、刘生应、鲁丽平、陈挺、仇相如、麦洪琦、陈颂昌、鲁俊和。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- JB/T 8268—1995（GB 10996—1989）、JB/T 8268—1999。

# 静电复印光导体表面缺陷测量方法

## 1 范围

本标准规定了静电复印光导体表面缺陷的测量条件、测量方法及测量报告。

本标准适用于静电复印（打印、传真、多功能）设备用的光导体的外观质量及背景印迹的测量。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 8271 静电复印光导体表面缺陷比对版

JB/T 8273 静电复印全黑测试版

## 3 测量条件

### 3.1 环境条件

温度：18℃～28℃。

湿度：40%RH～60%RH。

室内照度：400 lx～1 000 lx，在待测光导体周围应无阳光直射。

### 3.2 测量用样机

与待测鼓配套的静电复印（打印、传真、多功能）设备，并符合相关产品标准的要求。

## 4 测量方法

### 4.1 目视检查

#### 4.1.1 适用项目

光导体表面的塌角、伤痕、脱膜、污染、水印、指印、色泽异常、色泽不均匀以及麻点、凹坑、凸起、条道、针孔、气泡等外观质量项目。

#### 4.1.2 测量方法

从包装箱中小心取出待检光导体，两手支撑光导体两端，一边旋转，一边沿轴向左右来回检查光导体表面，反复三次以上，观测存在的缺陷。

注：测量版面范围为有效复印（打印）幅面宽度两端各加 5 mm。

### 4.2 对比测量

#### 4.2.1 适用项目

用缺陷版来对比检查光导体表面的麻点、凹坑、凸起、条道、针孔、气泡等缺陷。当目视检查中发

现表面有上述缺陷的光导体时，应进行对比测量。

#### 4.2.2 测量方法

以 JB/T 8271 规定的缺陷版为标准版与待检光导体表面的缺陷进行比较，按不同面积、长度分别计算出 A 型、B 型缺陷的个数，面积大于  $4 \text{ mm}^2$  的 A 型缺陷按  $4 \text{ mm}^2$  计算，长度大于  $9 \text{ mm}$  的 B 型缺陷按  $9 \text{ mm}$  计算，并填入测试记录。

### 4.3 背景印迹测量

#### 4.3.1 适用项目

用缺陷版来对比测量全黑和全白印品的缺陷。当对比测量不能判定或有异议时，应进行背景印迹测量。

#### 4.3.2 测量方法

4.3.2.1 将待检光导体装入试验样机，样机设为出厂设置。

4.3.2.2 以 JB/T 8273 规定的全黑测试版、全白测试版为原稿上机复印，用 JB/T 8271 规定的缺陷版与所得复印品背景印迹重合对比，计出全鼓面或  $\phi 50 \text{ mm}$  圆内的 A 型、B 型缺陷的面积与个数，并填入测试记录。

注：全白测试版用 5 张普通白色复印纸重叠代替。

### 5 测量报告

全部检查结束后应填写测量报告，内容如下：

- a) 本标准编号；
  - b) 产品名称、型号；
  - c) 生产厂家或委托测量单位；
  - d) 生产日期；
  - e) 样品编号；
  - f) 测试条件及日期；
  - g) 测试数据结果及有关统计；
  - h) 测量人员签名。
-

中 华 人 民 共 和 国  
机械行业标准  
静电复印光导体表面缺陷测量方法  
JB/T 8268—2015

\*

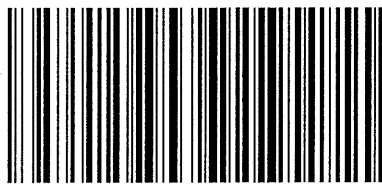
机械工业出版社出版发行  
北京市百万庄大街22号  
邮政编码：100037

\*

210mm×297mm·0.5印张·8千字  
2015年10月第1版第1次印刷

\*

书号：15111·12658  
网址：<http://www.cmpbook.com>  
编辑部电话：(010) 88379399  
直销中心电话：(010) 88379693  
封面无防伪标均为盗版



JB/T 8268-2015

版权专有 侵权必究